2026年度 研究テーマ指定助成事業

申請書

研究テーマの選択(複数選択可)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | ① | 積層プロセスを織り込んだDfAM(AM造形限界を考慮した形状最適化) | [ ]  | ⑥ | AM凝固割れの現象論的解析(PBF／DED) |
| [ ]  | ② | 溶融池現象のシミュレーションモデルの構築(PBF／DED／その他のプロセス) | [ ]  | ⑦ | AMミクロ組織の造形時と後熱処理との関係(PBF／DED) |
| [ ]  | ③ | ウォール厚さ・空間寸法などの造形限界について(PBF／DED／その他のプロセス) | [ ]  | ⑧ | AM造形物の残留応力解析と熱変形の実験・理論解析(PBF／DED) |
| [ ]  | ④ | インプロセスモニタリング(PBF／DED) | [ ]  | ⑨ | 造形対象の形状・サイズと入熱量が熱変形・残留応力に及ぼす影響(PBF／DED) |
| [ ]  | ⑤ | AMアークの放電・溶融池現象(DED-ARC) | [ ]  | ⑩ | AM造形物の機械的性質・じん性とAMプロセス/メタラジーとの関係 |

研究のタイトル

|  |
| --- |
|  |

申請者

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ①代表者(連絡者) | 氏名(フリガナ) |  |
| 生年月日(西暦) |  |
| 所属 | 機関・部署・役職 |  |
| 郵便番号・住所 |  |
| 連絡先 | E-mail |  |
| TEL |  |
| 学歴(最終学歴を記入) |  |
| 職歴 |  |
| 所属学会 | 日本溶接協会の活動に対する参加有無 | １． あり　　２． なし |
| 溶接学会 | １． 学会員［会員番号：　　　　　］　　２． なし |
| その他の所属学協会 |  |
| 研究分野 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ② | 氏名(フリガナ) |  |
| 生年月日(西暦) |  |
| 所属 | 機関・部署・役職 |  |
| 郵便番号・住所 |  |
| 連絡先 | E-mail |  |
| TEL |  |
| 学歴(最終学歴を記入) |  |
| 職歴 |  |
| 所属学会 | 日本溶接協会の活動に対する参加有無 | １． あり　　２． なし |
| 溶接学会 | １． 学会員［会員番号：　　　　　］　　２． なし |
| その他の所属学協会 |  |
| 研究分野 |  |
| ③ | 氏名(フリガナ) |  |
| 生年月日(西暦) |  |
| 所属 | 機関・部署・役職 |  |
| 郵便番号・住所 |  |
| 連絡先 | E-mail |  |
| TEL |  |
| 学歴(最終学歴を記入) |  |
| 職歴 |  |
| 所属学会 | 日本溶接協会の活動に対する参加有無 | １． あり　　２． なし |
| 溶接学会 | １． 学会員［会員番号：　　　　　］　　２． なし |
| その他の所属学協会 |  |
| 研究分野 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ④ | 氏名(フリガナ) |  |
| 生年月日(西暦) |  |
| 所属 | 機関・部署・役職 |  |
| 郵便番号・住所 |  |
| 連絡先 | E-mail |  |
| TEL |  |
| 学歴(最終学歴を記入) |  |
| 職歴 |  |
| 所属学会 | 日本溶接協会の活動に対する参加有無 | １． あり　　２． なし |
| 溶接学会 | １． 学会員［会員番号：　　　　　］　　２． なし |
| その他の所属学協会 |  |
| 研究分野 |  |
| ⑤ | 氏名(フリガナ) |  |
| 生年月日(西暦) |  |
| 所属 | 機関・部署・役職 |  |
| 郵便番号・住所 |  |
| 連絡先 | E-mail |  |
| TEL |  |
| 学歴(最終学歴を記入) |  |
| 職歴 |  |
| 所属学会 | 日本溶接協会の活動に対する参加有無 | １． あり　　２． なし |
| 溶接学会 | １． 学会員［会員番号：　　　　　］　　２． なし |
| その他の所属学協会 |  |
| 研究分野 |  |

* 申請者が6名以上の場合は、表を追加してください

|  |
| --- |
| １．研究の背景と目的 |
|  |
| ２．研究内容(審査において重要なポイントとなります。上記の目的を達成するために、1年間で実施する具体的な内容を簡潔に記入してください) |
|  |

|  |
| --- |
| ３．本研究に関する研究資金の応募・採択状況(研究資金［科研費、競争的資金制度等国費から支給される研究資金］の応募および採択実施中の研究課題、資金制度名称を記述してください) |
|  |
| ４．本研究で想定される成果 |
|  |

|  |
| --- |
| ５．本研究全体で想定される費用(どのようなことに使いたいかを1～2行で簡潔に記入してください。費用の記載は不要です。以下の記載例を参照願います)例1)　情報収集のため国際会議に出席したい例2)　AM解析用のソフトを購入したい例3)　試験用材料を購入したい例4)　学生をセミナーに参加させたい例5)　これから研究に着手するので準備費に充てたい※奨学寄付金として助成金を交付するため、研究終了後に会計報告を求めることはありません |
|  |
| ６．その他(PR等、自由に記入してください) |
|  |
| ７．溶接接合技術やAM技術などものづくり分野での最近5年間の活動内容及び特記する研究成果* 研究論文：　著者、論文名、掲載学会誌名、巻号頁、発行年
* 研究発表：　発表論文名、国内外会議名、主催者名、開催場所、期日
 |
|  |

申請書に記入できない研究に関する資料等がありましたら、別途ご送付をお願いします